

기술분석보고서 IT

에이엔피(015260)

- 요약
- 기업현황
- 시장동향
- 기술분석
- 재무분석
- 주요 변동사항 및 전망

작성기관 나이스평가정보(주) 작성자 주예령 연구원

 YouTube 요약 영상 보러가기

- 본 보고서는 투자 의사결정을 위한 참고용으로만 제공되는 것이므로, 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 보고서를 활용한 어떠한 의사결정에 대해서도 본회와 작성기관은 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 본 보고서의 요약영상은 유튜브로도 시청 가능하며, 영상편집 일정에 따라 현재 시점에서 미공개 상태일 수 있습니다.
- 텔레그램에서 “한국IR협의회” 채널을 추가하시면 매주 보고서 발간 소식을 안내 받으실 수 있습니다.
- 본 보고서에 대한 자세한 문의는 작성기관(TEL.02-2124-6822)로 연락하여 주시기 바랍니다.

에이엔피(015260)

자동차 전장 PCB 45년 노하우, 로봇·전기차 미래를 설계하다

기업정보(2026.07.16 기준)

대표자	전운관
설립일자	1981.01
상장일자	1988.01
기업규모	중견기업
업종분류	인쇄회로기판용 적층판 제조업
주요제품	전자부품 (인쇄회로기판)

시세정보(2026.07.16 기준)

현재가(원)	335
액면가(원)	500
시가총액(억 원)	205
발행주식수	47,116,894
52주 최고가(원)	1,077
52주 최저가(원)	280
외국인지분율	-
주요주주	㈜와이에스피 등 5인

■ 전자산업 기반의 자동차 전장 특화 PCB 전문 제조기업

에이엔피(이하 동사)는 1977년 창사 이래 인쇄회로기판(PCB) 제조를 주력 사업으로 하는 코스피 업체이다. 동사는 자동차 전장부품, 정보통신, 산업용 네트워크 등 다양한 분야에 활용되는 경성 PCB를 생산하며, 현대 모비스·현대케피코 등 국내 완성차 핵심 협력사를 안정적인 고객으로 확보하고 있다. PCB 부문이 전체 매출의 약 78.9%를 차지하는 가운데, 인천 남동공장에서 양·단면 및 다층 PCB를 생산하며 연간 가동률 85.3%를 유지하고 있는 것으로 확인된다. 수출 42%, 내수 58%의 안정적 판로 구조를 바탕으로 초다층 제품 판매 비중을 지속 확대하며 고부가가치 구조로의 전환을 추진하고 있다.

■ 자동차 시트 사업 병행으로 종합 자동차 부품 공급사로 도약

동사는 2022년 7월 최대주주인 (주)와이에스피로부터 자동차 시트 제조 사업부문을 영업양수하며 신규 사업 영역을 확대하였다. 청주 공장을 거점으로 현대·기아자동차의 1차 협력사인 (주)용산에 시트 및 퀴팅 사양 제품을 공급하고 있으며, 현대·기아차 협력사 품질보증서(SQ 인증) S등급을 유지하며 안정적인 납품 체계를 구축하고 있다. 인건비 집약적 봉제 공정의 품질 안정화와 사내 미싱사 양성 교육 체계가 경쟁력의 기반이 되고 있으며, 전자부품과 자동차 내장 부품을 아우르는 복합 제조 역량이 동사의 차별적 경쟁력으로 작용하고 있는 것으로 판단된다.

■ 고부가 제품 전환과 로봇·전기차 신성장 분야 진출 본격화

동사는 2026년 들어 고사양·고적층 PCB로의 포트폴리오 전환을 본격화하고 있다. 자동차 전동화 가속에 따른 전장용 고사양 PCB 수요 증가에 대응하기 위해 대표이사 및 특수관계인이 직접 참여하는 제3자배정 유상증자를 통해 신규 생산 설비 투자 자금을 확보하였다. 아울러 로봇 산업으로도 사업 영역을 확장하여 액추에이터용 PCB 경쟁력 강화에 나서고 있으며, 우주항공 및 정밀공학 분야로의 기술 개발 역량 확대를 병행 추진하고 있는 것으로 확인된다.

요약 투자지표 (K-IFRS 연결 기준)

	매출액 (억 원)	증감 (%)	영업이익 (억 원)	이익률 (%)	순이익 (억 원)	이익률 (%)	ROE (%)	ROA (%)	부채비율 (%)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)
2023	1,409.1	31.13	-18.2	-1.30	-100.2	-7.11	-31.64	-9.93	194.69	-227	714	N/A	1.89
2024	1,134.9	-19.46	-59.9	-5.28	-103.4	-9.11	-35.66	-10.97	261.52	-229	573	N/A	1.01
2025	1,174.9	3.52	-72.9	-6.21	-141.9	-12.07	-60.92	-14.72	384.42	-313	455	N/A	0.95

기업경쟁력

장기 완성차 공급 이력

- 현대모비스·현대케피코 등 국내 완성차 핵심 협력사를 고객으로 확보하여 PCB 매출의 80% 이상을 점유
- ISO/TS16949·ISO14001 등 다중 품질 인증 유지로 자동차 전장 공급망 내 신뢰도 확보
- • 100% 주문 생산 체제로 고객 맞춤 대응력 강화

고다층 PCB 기술 역량

- 1997년 18층 초고다층 임피던스 PCB 양산 개시 이후 기술 지속 고도화
- 10층 이상 초다층(MLB) 및 고사양·고적층 제품 설계·양산 역량 보유
- 인천 남동공장 일관 생산 체제와 종속기업 (주)우진 외주 가공을 통한 유연한 생산 대응

핵심 기술 및 적용제품

다층 인쇄회로기판 (MLB)

- 6층 이상 초다층 구조로 신호 무결성·임피던스 제어가 요구되는 자동차 전장·통신장비용 고부가 PCB를 양산하며, 전체 PCB 매출의 약 70%를 차지하는 핵심 제품군이다.

자동차 시트 커버 (SEAT COVER)

- 청주 공장에서 가죽·TPU 등 소재를 활용한 재단·봉제·퀵팅 공정을 통해 현대·기아자동차 시트 부품을 생산하며, SQ 인증 S등급 기반의 완성차 직납 체계를 보유하고 있다.

<동사 주요 생산품>



시장경쟁력

글로벌 자동차용 PCB 시장

- 2023년 97억 9,260만 달러 규모에서 연평균 5.3% 성장하여 2030년 140억 9,160만 달러에 이를 것으로 전망되며, 전기차·ADAS 확대가 전장 PCB 수요를 구조적으로 견인하고 있다.

전기차 전장용 PCB 성장

- 글로벌 PCB 시장은 2025년 기준 약 957억 달러로 추산되며 2031년까지 연평균 4.83% 성장이 전망되는 가운데, 전기차 한 대당 PCB 탑재 규모가 내연기관 차량 대비 두 배로 증가하는 구조적 성장 흐름이 동사의 전장 PCB 사업에 우호적으로 작용하고 있다.

로봇 분야 신규 시장

- 정부의 지능형 로봇 산업 육성 방침과 대기업들의 로봇 사업 본격 추진으로 액추에이터용 고사양 PCB 수요가 빠르게 형성되고 있으며, 동사는 해당 분야로의 적용처 확대를 통해 시장 다변화를 추진하고 있다.

I. 기업 현황

45년 전장 PCB 노하우에 자동차 시트·EMS를 더한 복합 제조기업

동사는 1977년 창사 이래 자동차 전장용 PCB를 주력 생산 기업으로, 2022년 자동차 시트 사업에 신규 진출하여 PCB·시트·EMS를 아우르는 복합 제조사업 구조를 갖추고 있으며, 현대모비스·현대캐피코 등 완성차 핵심 협력사를 주요 고객으로 확보하여 안정적인 매출 기반을 유지하고 있다.

■ 기업 개요 및 주요 연혁

동사는 1977년 우진전자산업사로 출발하여 1981년 우진전자 주식회사로 법인 전환한 이래, 인쇄회로기판(PCB) 제조를 창사 이래의 주업종으로 유지해 온 코스피 상장 기업이다. 1988년 한국증권거래소에 주식을 상장하며 기업을 공개하였고, 2009년 현재의 상호로 변경하였다. 2022년에는 PCB 제조사업부문을 물적분할하여 종속기업 (주)우진을 설립하는 한편, (주)와이에스피로부터 자동차 시트 제조사업부문을 영업양수하며 사업 구조를 다각화하였다. 인천 남동공장을 본거지로 ISO/TS16949·ISO14001 등 주요 인증을 유지하며 안정적인 제조 기반을 구축하고 있는 것으로 확인된다.

그림 1. 주요 연혁



자료: 동사 사업보고서(2025.12.), NICE평가정보(주) 재가공

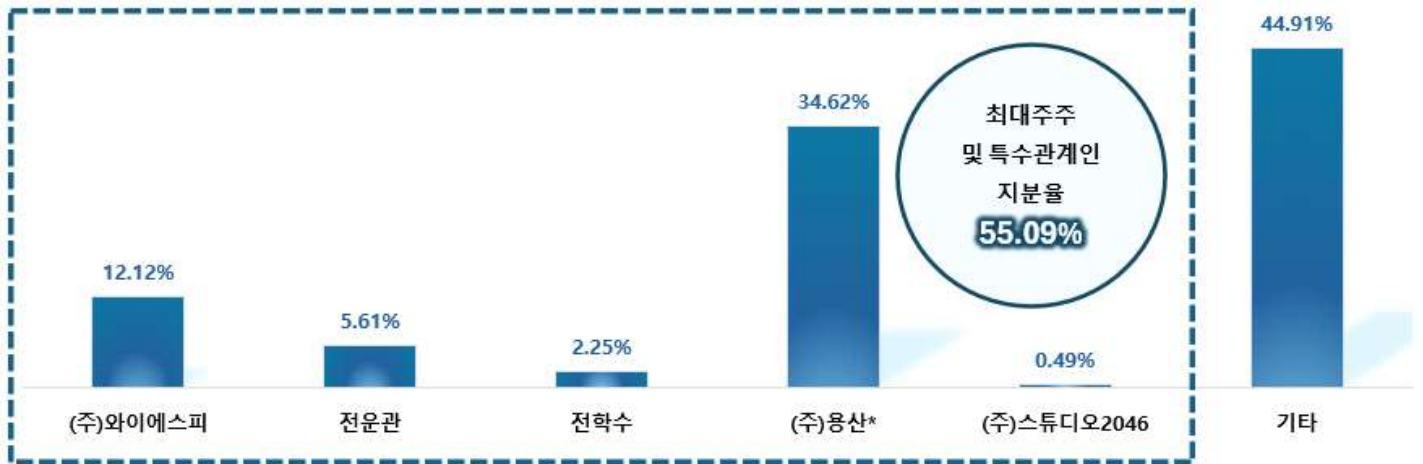
■ 대표이사 주요 이력

전운관 대표이사는 (주)에이엔피 및 관계사인 (주)용산 회장을 겸임하고 있으며, 이사 총 재직 기간 156개월(임기 만료 예정 2028년 3월)의 장기 경영 총수로서 동사의 전략 방향을 주도하고 있다. 연임 4회를 거치는 동안 PCB 고다층 생산설비 증설(2011년), 인천 남동공장 취득(2017년) 및 공장 통합(2021년), 자동차 시트 사업 영업양수(2022년) 등 주요 성장 전략을 직접 총괄한 것으로 확인된다. 2026년에는 고사양·고적층 PCB 전환 전략과 로봇 산업 신규 진출을 진두지휘하며, 제3자배정 유상증자에 오퍼로서 직접 참여하여 책임 경영 의지를 실천에 옮기고 있는 것으로 판단된다.

■ 주주 현황

동사의 주주현황을 살펴보면, 최대주주인 (주)와이에스피는 5,712,634주(지분율 12.12%)를 보유하고 있다. 특수관계인으로는 대표이사 전운관 2,643,480주(5.61%), (주)용산 16,310,535주(34.62%, 상호보유주식으로 의결권 없음), 전학수 1,062,063주(2.25%), (주)스튜디오2046 230,000주(0.49%)를 각각 보유하고 있다. 의결권 있는 주식 기준으로 (주)와이에스피 및 전운관·전학수 등 특수관계인의 합산 지분율은 약 20.37%이며, (주)용산 보유분은 상호보유주식으로 의결권이 제한되어 있어 실질 의결권 집중도는 제한적인 것으로 판단된다.

그림 2. 주주 현황



자료: 동사 분기보고서(2026.03), NICE평가정보(주) 재가공

*의결권 없는 상호보유주식 (2026년 1분기 분기보고서 기말 기준)

■ 사업 분야

동사는 인쇄회로기판(PCB) 제조 및 자동차 구성품 사업을 영위하고 있다.

표 1. 주요 사업 분야

매출유형	품목	제품 설명
인쇄회로기판(PCB)	양·단면 PCB, 다층 PCB	자동차 전장, 통신장비, 산업용 네트워크 등에 적용되는 경성 PCB 제조·판매
자동차 구성품	SEAT COVER, 퀴팅 사양 제품	자동차 시트 재단·봉제·퀴팅 공정을 통한 내장 부품 제조 및 (주)용산 납품
EMS	SMT 가공, 전자부품 조립	고객사 위탁 전자부품 조립·가공 서비스
기타	부산물 매각 등	생산 과정 부산물 처리 및 기타 수익

자료: 동사 사업보고서(2025.12.), NICE평가정보(주) 재가공

인쇄회로기판 사업은 동사의 창사 이래 핵심 사업부문으로, 전체 연결 매출의 대부분을 차지하는 주력 사업이다. 동사가 생산하는 PCB는 전자제품 내 각 부품 간의 전기·전자 신호 흐름을 제어하는 핵심 배선판으로, 자동차 전장부품을 비롯하여 통신장비, 산업용 네트워크, 정보통신 기기 등 광범위한 분야에 공급된다. 제품은 양·단면 인쇄회로기판과 다층(Multi Layer) 인쇄회로기판으로 구분되며, 다층 PCB 비중이 주를 이루는 가운데 초다층(MLB) 제품 판매 비중을 지속 확대하는 전략을 추진하고 있다. 주요 고객사인 현대모비스, 현대캐피코 등 완성차 핵심 협력사가 PCB 매출의 대부분을 차지하고 있으며, 생산은 인천 남동공장(남동대로 248)에서 이루어지고 있다. 100% 주문 생산 방식을 채택하고 있으며, 수출(간접수출 포함)과 내수를 균형 있게 병행하는 안정적 판로 구조를 갖추고 있는 것으로 확인된다. 이러한 판로 구조는 특정 시장 의존도를 낮추고 환경 변화에 유연하게 대응할 수 있는 기반이 되고 있는 것으로 판단된다. 2022년 PCB 제조사업부문 물적분할로 설립된 종속기업 (주)우진이 외주 가공을 담당하며 생산 유연성을 지원하고 있으며, 원재료는 동박적층판(CCL)·프리프레그·동박 등을 두산·생익·코부산업 등 다수의 소재사에서 분산

조달하여 공급망 안정성을 확보하고 있다. 고객사 완성차 품질 기준 충족을 위한 다중 품질 인증 체계를 갖추고 있으며, 지속적인 연구개발 투자를 통해 고사양 전장 PCB 설계·제조 역량을 고도화하고 있어, 전장 특화 PCB 제조기업으로서의 기술적 경쟁력을 강화하고 있는 것으로 파악된다. 특히 자동차 전장 환경에 요구되는 내열성·신호 무결성 등 고사양 요건을 충족하는 제품 개발에 집중하며 고부가 포트폴리오 전환을 가속화하고 있으며, 이러한 기술 고도화 노력이 중장기 사업 경쟁력 제고의 핵심 동력으로 자리하고 있는 것으로 확인된다.

자동차 구성품 사업은 2022년 7월 최대주주 (주)와이에스피로부터 자동차 시트 제조 사업부문을 영업양수하여 진출한 사업으로, 청주 공장에서 SEAT COVER(시트 커버) 및 퀴팅 사양 제품을 생산하고 있다. 생산된 제품은 현대·기아자동차의 1차 협력사인 (주)용산을 통해 기아자동차 완성차에 납품되고 있으며, 청주 공장은 가동 여력을 초과하는 높은 생산 강도를 유지하고 있어 안정적인 수주 기반과 생산 효율성을 확인할 수 있다. 현대·기아차 협력사 품질보증서(SQ 인증) S등급을 유지하며 완성차 업계 내 높은 신뢰를 확보하고 있으며, 이는 동사의 자동차 구성품 사업이 단순 외주 제조를 넘어 완성차 공급망 내에서 안정적 파트너로 자리매김하고 있음을 방증하는 것으로 평가된다. 주요 원재료인 가죽은 고객사 (주)용산으로부터 유상사급 방식으로 공급받고 있으며, PP보드·매직테이프·지퍼·재봉사 등 부자재는 부강테크·유엠에스·유림인더스트리 등 협력사로부터 조달하고 있다. 인테리어 부품의 친환경·고감성화 실현이라는 경영 이념 아래 품질 혁신을 지속하고 있으며, 완성차 협력사 인증 기반의 안정적 납품 채널이 동 사업부문의 핵심 경쟁력으로 기능하고 있는 것으로 판단된다. 아울러 경기 의왕 거점의 EMS(전자부품 조립) 사업도 병행하고 있어 SMT 가공 및 전자부품 위탁 조립 분야에서도 매출을 창출하고 있으며, 종속기업 (주)스튜디오2046을 통해 공연 기획 및 콘텐츠 제작 사업도 영위하고 있는 것으로 확인된다.

그림 3. 동사 주요 생산품



자료: 동사 홈페이지

II. 시장 동향

전기차·자율주행이 이끄는 글로벌 자동차용 PCB 시장의 성장

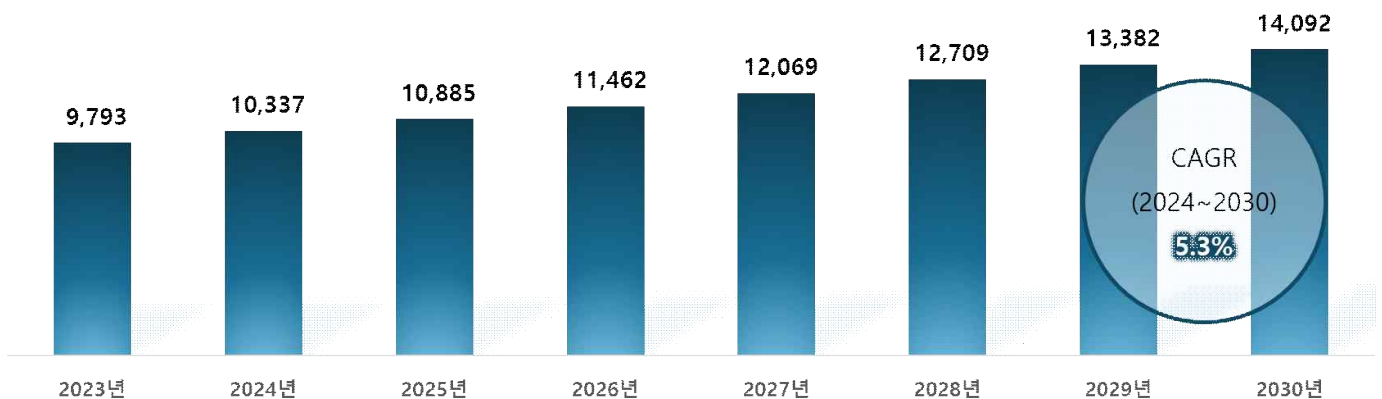
글로벌 자동차용 PCB 시장은 연평균 5.3% 성장하여 2030년 140억 9,160만 달러에 이를 것으로 전망되며, 전기차 전동화 가속과 ADAS 기술 고도화가 자동차 전장 PCB 수요를 구조적으로 견인하는 가운데, 동사가 추진 중인 고부가 전장 PCB 전환 전략이 시장 방향성과 부합하는 것으로 파악된다.

■ 국내외 시장 규모 및 성장률

Grand View Research에 따르면, 글로벌 자동차용 PCB(인쇄회로기판) 시장의 2023년 시장 규모는 97억 9,260만 달러로 추산되며, 연평균 5.3%씩 증가하여 2030년에는 140억 9,160만 달러의 규모를 형성할 것으로 전망된다. 이는 전기차(EV) 보급 확대와 ADAS·자율주행 기능 고도화에 따른 차량 내 전장 PCB 탑재량 증가, 그리고 아시아태평양 지역을 중심으로 한 자동차 생산 확대가 성장을 견인하고 있기 때문으로 판단된다. 세그먼트별로는 양면 PCB(Double-Sided PCB)가 전체 시장에서 가장 높은 매출 비중을 차지하고 있으며, 지역별로는 아시아태평양이 2023년 기준 최대 매출 시장을 형성하고 있는 것으로 확인된다. 이러한 추세가 유지된다고 가정하면, 2030년 글로벌 자동차용 PCB 목표시장의 규모는 140억 9,160만 달러에 이를 것으로 전망된다.

그림 4. 글로벌 자동차용 PCB 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



자료: Grand View Research(2024), NICE평가정보㈜ 재가공

■ 시장 구조 및 산업동향

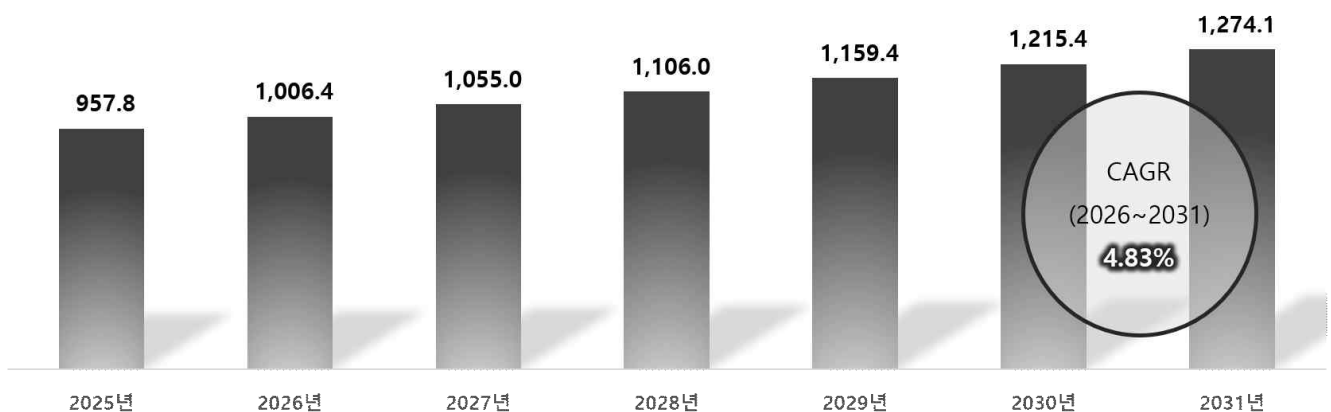
국내 경성 인쇄회로기판 시장은 소수의 대형 기업이 높은 점유율을 차지하는 과점 구조를 형성하고 있다. 삼성전기·대덕전자·심텍 등 매출 5,000억 원 이상의 대형 업체가 전체 시장의 60~70%를 점유하는 것으로 추정되며, 그 외 디에이피·현우산업 등 중견 업체와 100여 개의 군소 업체들이 나머지를 분점하고 있다. 중국·대만 등 아시아 생산기지의 저가 공세가 심화됨에 따라 국내 범용 PCB 시장의 경쟁 강도는 지속 높아지는 추세이며, 이는 국내 경성 PCB 시장 전체의 시장 규모 감소세와 맥을 같이하고 있다. 특히 자동차 전장용 PCB 시장은 완성차 업체를 정점으로 하는 수직적 공급망 구조 내에서 협력사 인증이 필수적이어서 신규 진입 장벽이 상대적으로 높게 형성되어 있으며, 인증을 보유한 기존 협력사들이 안정적인 공급 채널을 유지하는 구조적 특성이 있는 것으로 파악된다.

에이엔피(015260)

글로벌 PCB 시장에서는 전기차(EV) 전동화 가속, AI 서버 인프라 확장, 5G 통신망 구축이 맞물리면서 고사양·고적층 제품 중심으로 수요가 빠르게 재편되고 있다. 전기차 한 대에 탑재되는 PCB는 내연기관 차량 대비 두 배 수준인 150~200달러에 달하며 전장 PCB 시장의 구조적 성장을 이끌고 있는 것으로 확인된다. 글로벌 PCB 시장 규모는 2025년 약 957억 8천만 달러로 추산되며 2031년까지 연평균 4.83% 성장이 예상되는 가운데, 핵심 성장 동인은 AI 가속기, EV 전력 전자 장치, 차세대 통신 네트워크 등 고부가 애플리케이션으로 이동하고 있는 것으로 확인된다. 국내외 PCB 업체들이 반도체 패키지 기판(FC-BGA) 및 고다층 MLB 등으로 사업 전환을 가속화하는 가운데, 자동차 전장 특화 역량을 보유한 업체들에게 전기차 시장의 성장은 중요한 기회 요인으로 평가된다.

그림 5. 글로벌 PCB 시장 규모 및 전망

(단위: 억 달러)



자료: Mordor Intelligence(2026), NICE평가정보(주) 재가공

■ 기술 개발 및 경쟁 환경

국내 경성 PCB 시장의 경쟁 구도는 기술 난도와 제품 사양에 따라 명확히 차별화되어 있다. 자동차 전장·산업용 고다층 PCB 시장에서는 대덕전자, 디에이피, 코리아씨키트 등이 주요 경쟁자로 포진해 있으나, 이들 대형 업체들은 최근 AI 반도체 패키지 기판(FC-BGA) 등으로의 사업 전환을 가속화하고 있는 것으로 파악된다. 중국산 저가 제품과의 가격 경쟁이 심화되는 가운데, 완성차 협력사 인증을 보유한 자동차 전장 특화 PCB 업체들은 고객사와의 장기 공급 관계를 유지하는 구조적 이점을 갖추고 있는 것으로 확인된다. 자동차 전동화 가속과 함께 전장용 PCB에 대한 사양 고도화 요구가 증가하고 있어 고사양 대응 역량이 경쟁의 핵심 변수로 부상하고 있는 것으로 판단된다.

표 2. 국내 경쟁업체 현황

기업명	주요 사업 내용
대덕전자	• 자동차 전장용 고다층 PCB 및 FC-BGA 반도체 기판을 주력으로 생산하며, AI 반도체 기판으로의 사업 포트폴리오 전환을 가속화하고 있다.
디에이피	• 자동차용 PCB 및 차량 레이더 PCB, 경성 HDI 기판 등을 생산하며, 자동차 전장 및 통신 분야에 걸쳐 고사양 제품 라인업을 운영하고 있다.
코리아씨키트	• 경성 PCB 및 고다층 PCB를 생산하는 가운데, FC-BGA 반도체 패키지 기판으로의 사업 전환을 추진하며 포트폴리오를 고부가화하고 있다.

자료: 업체 홈페이지 및 보도자료, NICE평가정보(주) 재가공

III. 기술분석

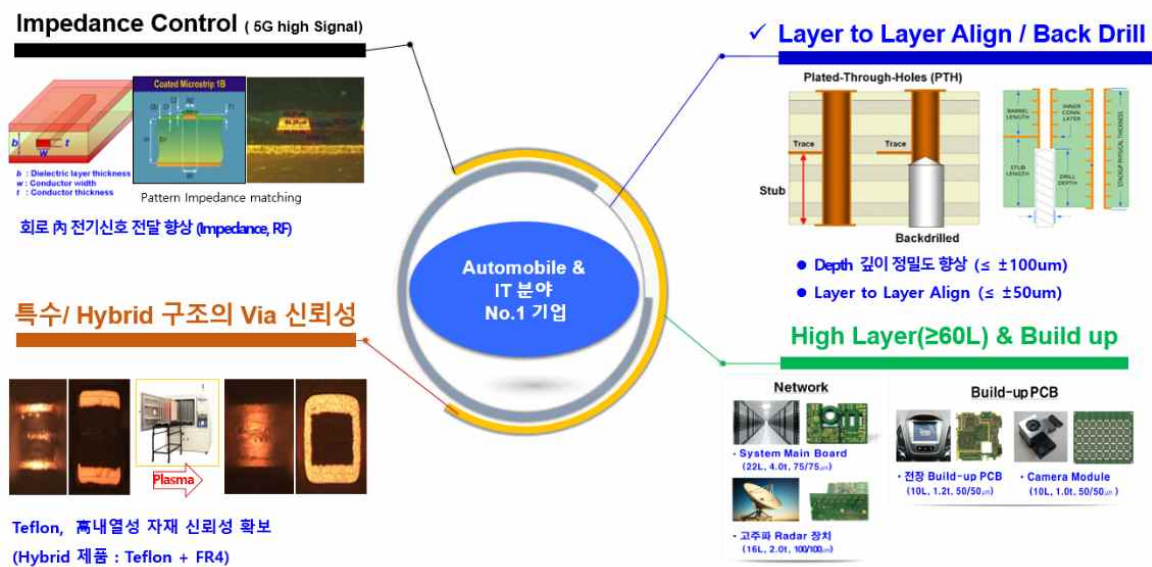
45년 전장 PCB 제조 이력이 증명하는 고다층·임피던스 제어 기술력

동사는 1997년 18층 초고다층 임피던스 PCB 양산 개시 이후 지속적인 기술 고도화를 통해 10층 이상 초다층(MLB) 제품 설계·양산 역량을 갖추고 있으며, ISO/TS16949·ISO14001 등 다중 품질 인증과 자동차 전장 특화 공급 이력이 기술 신뢰성의 근거가 되고 있는 것으로 확인된다.

■ 고다층·고집적 인쇄회로기판 설계 및 양산 기술

동사는 1997년 18층 초고다층 임피던스 PCB 양산을 시작한 이래 고다층 PCB 제조 기술을 지속 발전시켜 왔다. 현재 10층 이상 초다층(MLB) 제품 생산 역량을 보유하고 있으며, 임피던스 제어 기술이 요구되는 자동차 전장용·통신장비용 특수 PCB를 안정적으로 양산하고 있는 것으로 확인된다. 주요 원재료인 동박적층판(CCL), 프리프레그(Prepreg), 동박(Copper Foil) 등을 두산·생익 등 국내외 주요 소재사로부터 조달하며, 드릴·포토리소그래피·에칭·도금·표면처리 등 PCB 제조 전 공정을 인천 남동공장에서 일괄 수행하는 수직 계열화된 생산 체계를 갖추고 있다. ISO/TS16949, ISO14001, Single PPM·100PPM 인증, 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)·경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ) 인증 등을 취득하여 자동차 전장용 PCB에 요구되는 엄격한 다중 품질 기준을 충족하고 있다. 2011년 고다층 기판 생산설비를 증설한 이후 현재 연간 가동률 85.3%를 유지하며 안정적인 대량 공급 역량을 확보하고 있으며, PCB 제조의 전문 기술과 장치산업으로서의 생산 인프라가 진입 장벽으로 기능하여 기존 거래처와의 공급 관계를 공고히 하고 있는 것으로 판단된다. 또한 물적분할로 설립한 종속기업 (주)우진이 외주 가공을 담당하며 생산 유연성과 효율성을 지원하고 있다.

그림 6. 동사 주요 연구분야



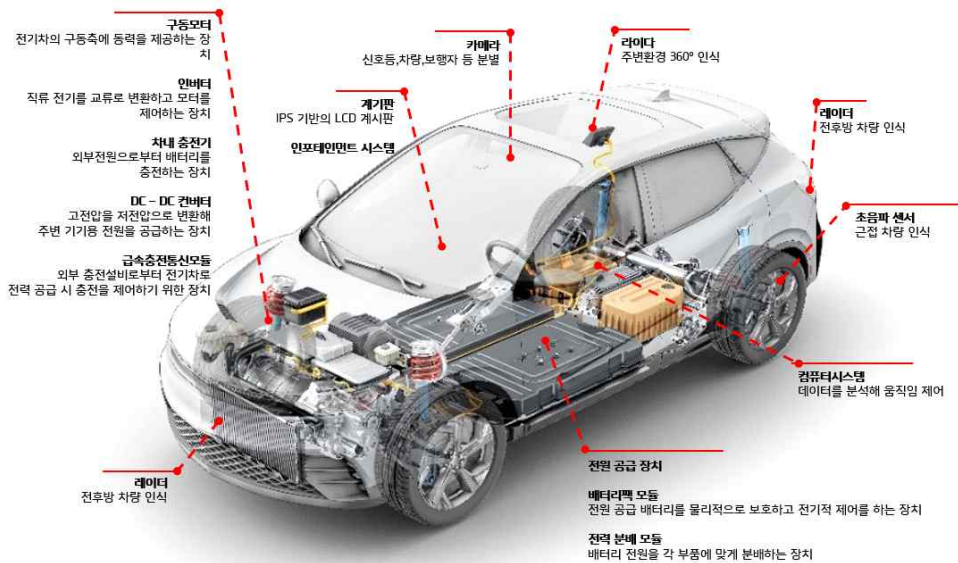
- Hybrid 제품 정합 및 내열성 강화기술 연구개발
- Layer 별 회로 Dimension 및 Scale 관리기술 연구개발
- 6G와 자율주행 자동차 대응을 위해 High speed / High frequency 원자재 연구개발
- 고신뢰성 전장 PCB 개발을 위한 Build-up Technology 연구개발

자료: 동사 홈페이지

■ 자동차 전장 특화 PCB 기술 및 고사양 제품 대응 역량

동사는 자동차 전장 분야를 중심으로 10층 이상 초다층 PCB와 고사양·고적층 제품 개발 역량을 갖추고 있다. 현대모비스·현대캐피탈 등 국내 대표 완성차 1차 협력사들에게 자동차 엔진 제어, 새시 제어, 전기 시스템 제어 등 다양한 용도의 전장용 PCB를 안정적으로 공급하고 있으며, 내수 58%·수출(간접수출 포함) 42%의 균형 잡힌 글로벌 판로 구조를 갖추고 있는 것으로 확인된다. 동사가 보유한 산업재산권(특허권)을 기반으로 회로 미세화, 신호 무결성(Signal Integrity) 확보, 내열·내환경성 강화 등 자동차 전장 환경에 최적화된 PCB 설계·제조 기술을 지속 고도화하고 있다. 2026년에는 고사양 PCB 생산 설비를 신속 구축하여 고부가 제품 양산 전환을 가속화하겠다는 전략 하에 설비 투자를 단행하였으며, 고적층·고집적 기술력을 이미 갖추고 있어 빠른 시간 내 양산 전환이 가능한 것으로 판단된다. 완성차 핵심 협력사와의 장기 공급 관계 및 전장 특화 기술력은 동사의 핵심 경쟁 우위로 평가된다.

그림 7. 동사 생산 자동차 전장품 종류

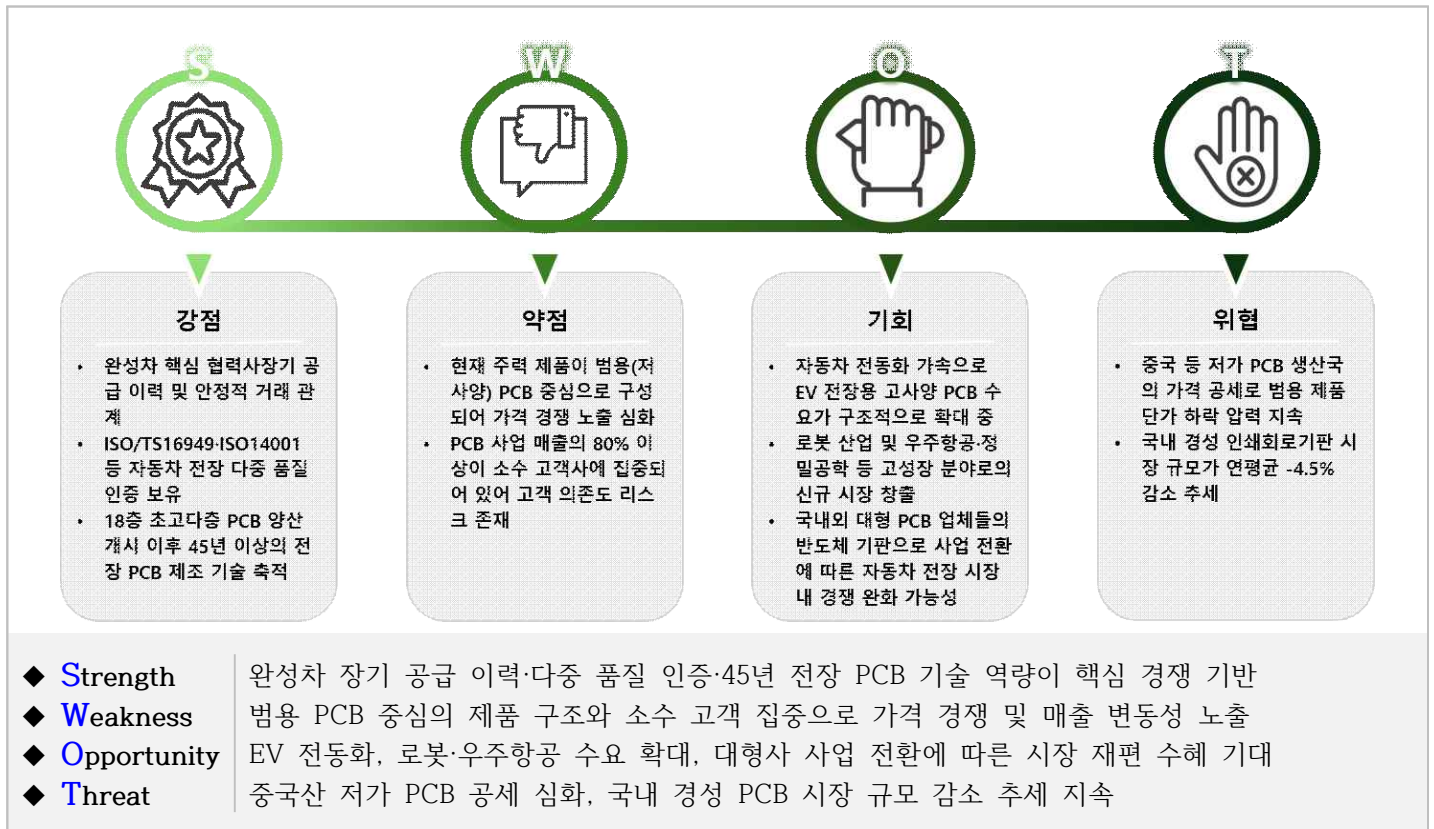


자료: 동사 홈페이지

■ 자동차 시트 봉제·품질 관리 기술 및 EMS 전자부품 조립 역량

자동차 구성품 부문에서는 청주 공장의 사내 미싱사 양성 교육과 체계적인 품질 혁신 활동을 통해 현대·기아자동차 협력사 품질보증서(SQ 인증) S등급을 지속 유지하고 있다. SEAT COVER의 재단·봉제·퀵팅 사양 생산 공정에서 가죽·TPU·PP보드·재봉사 등 원자재를 가공하는 전 과정을 일관 생산 체계로 운영하고 있으며, 주요 원재료인 가죽은 고객사 (주)용산으로부터 유상사급 방식으로 안정적으로 조달받아 원재료 수급 리스크를 최소화하고 있다. 청주 공장의 평균 가동률은 연장·특근을 포함하여 110.9%에 달하는 풀가동 상태로 운영되고 있어 높은 생산 효율성과 고객 수요 대응력을 실현하고 있는 것으로 파악된다. 또한 부강테크·유엠에스·유림인더스트리 등 다양한 부자재 공급업체와의 안정적인 협력 관계를 통해 공급망 리스크를 분산하고 있는 것으로 확인된다. 아울러 경기 의왕 거점의 EMS 사업에서는 SMT(표면실장기술) 가공 및 전자부품 조립 서비스를 제공하며 다양한 고객사의 전자 부품 조립·가공 위탁 수요에 대응하고 있다. 이러한 PCB 전장 기술과 자동차 내장 부품 생산 역량의 결합이 동사를 종합 자동차 솔루션 파트너로 포지셔닝하는 기술적 기반을 구성하고 있는 것으로 확인된다.

SWOT 분석



PEST 분석



IV. 재무분석

PCB 포트폴리오 전환 추진 중인 PCB·자동차시트 복합 제조 기업

동사의 2025년 매출액은 인쇄회로기판 부문 물량 회복에 힘입어 전년 대비 3.5% 증가한 1,174.9억 원을 기록하였고, 영업손실은 72.9억 원으로 전년 대비 적자 규모가 확대된 흐름을 시현하였다. 2026년 1분기에는 매출액 278.3억 원, 영업손실 11.1억 원, 당기순손실 27.2억 원을 시현하였다.

■ 인쇄회로기판 부문 회복에 따른 매출 성장 및 사업 포트폴리오 전환 추진

동사는 인쇄회로기판(PCB) 및 전사관리부문, 자동차시트부문, 전문생산방식(EMS)부문, 기타부문 등 4개 사업부문을 운영하고 있으며, 2025년 매출 구성은 인쇄회로기판(82.6%), 자동차부품(13.7%), 전문생산방식(3.3%), 기타매출(0.5%) 순으로 인쇄회로기판 부문이 절대적 비중을 차지하고 있다.

2024년 매출액은 인쇄회로기판 및 자동차시트 부문 매출 흐름 조정과 함께 전년 대비 19.5% 축소된 1,134.9억 원을 나타내었다.

2025년에는 인쇄회로기판 부문 매출 흐름 개선과 함께 전년 대비 3.5% 성장한 1,174.9억 원을 기록하였다.

■ 인쇄회로기판 매출 회복에도 영업손실 확대된 가운데 1분기 적자 규모 축소 시현

2024년 동사는 매출 흐름 축소와 함께 영업손실 59.9억 원을 기록하였으며, 영업이익률은 -5.3%를 나타내었다. 당기순손실은 103.4억 원으로 전년과 유사한 수준을 유지하였으며, 순이익률은 -9.1%를 시현하였다.

2025년에는 매출 흐름 회복과 함께 영업손실이 전년 대비 확대된 72.9억 원을 기록하였으며, 영업이익률은 -6.2%를 나타내었다. 당기순손실은 141.9억 원으로 전년 대비 순손실 규모가 확대된 흐름을 시현하였으며, 순이익률은 -12.1%를 나타내었다.

2026년 1분기에는 매출이 전년 동기 대비 8.9% 축소된 278.3억 원을 나타낸 가운데, 영업손실은 11.1억 원을 기록하였다. 당기순손실은 27.2억 원으로 전년 동기 대비 적자 규모가 축소된 흐름을 시현하였다.

그림 8. 동사 손익계산서 분석

(단위: 억 원, %, K-IFRS 연결 기준)



자료: 동사 사업보고서(2025.12.), 분기보고서(2026.03.), NICE평가정보(주) 재가공

■ 유상증자 완료로 자본 확충 추진된 가운데 재무 안정성 개선 기반 마련 흐름

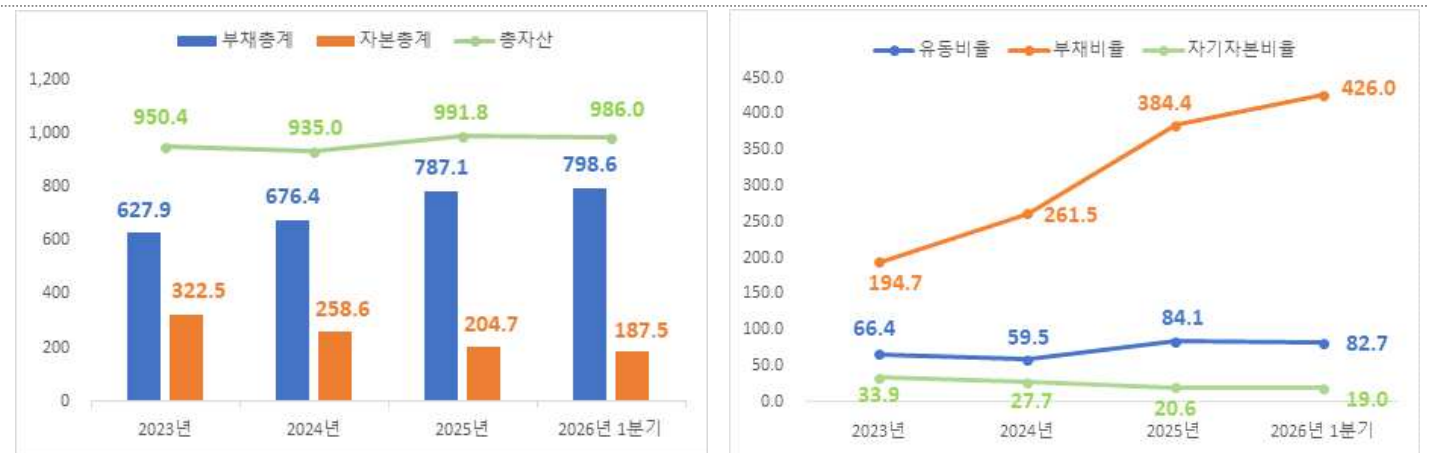
2024년 동사는 총자산이 전년 대비 15.3억 원 감소한 935.0억 원을 기록하였고, 부채총계는 48.5억 원 증가한 676.4억 원, 자본총계는 63.9억 원 감소한 258.6억 원을 나타내었다(유동비율 6.9%p 하락한 59.5%, 부채비율 66.8%p 상승한 261.5%, 자기자본비율 6.3%p 하락한 27.7%).

2025년에는 차입 규모 증가의 영향으로 총자산이 전년 대비 56.8억 원 증가한 991.8억 원을 기록하였고, 부채총계는 110.7억 원 증가한 787.1억 원, 자본총계는 53.9억 원 감소한 204.7억 원을 나타내었다(유동비율 24.6%p 상승한 84.1%, 부채비율 122.9%p 상승한 384.4%, 자기자본비율 7.0%p 하락한 20.6%).

2026년 1분기 동사는 총자산이 전년 동기 대비 39.9억 원 증가한 986.0억 원을 기록하였고, 부채총계는 72.3억 원 증가한 798.6억 원, 자본총계는 32.4억 원 감소한 187.5억 원을 나타내었다(유동비율 26.1%p 상승한 82.7%, 부채비율 95.7%p 상승한 426.0%, 자기자본비율 4.2%p 하락한 19.0%).

그림 9. 동사 재무상태표 분석

(단위: 억 원, %, K-IFRS 연결 기준)



자료: 동사 사업보고서(2025.12.), 분기보고서(2026.03.), NICE평가정보(주) 재가공

표 3. 동사 요약 재무제표

(단위: 억 원, %, K-IFRS 연결 기준)

항목	2023년	2024년	2025년	2025년 1분기	2026년 1분기
매출액	1,409.1	1,134.9	1,174.9	305.5	278.3
매출액증가율(%)	31.1	-19.5	3.5	-	-8.9
영업이익	-18.2	-59.9	-72.9	-21.7	-11.1
영업이익률(%)	-1.3	-5.3	-6.2	-7.1	-4.0
순이익	-100.2	-103.4	-141.9	-38.8	-27.2
순이익률(%)	-7.1	-9.1	-12.1	-12.7	-9.8
부채총계	627.9	676.4	787.1	726.3	798.6
자본총계	322.5	258.6	204.7	219.9	187.5
총자산	950.4	935.0	991.8	946.2	986.0
유동비율(%)	66.4	59.5	84.1	56.6	82.7
부채비율(%)	194.7	261.5	384.4	330.3	426.0
자기자본비율(%)	33.9	27.7	20.6	23.2	19.0
영업현금흐름	57.2	-36.0	-119.8	16.6	-26.7
투자현금흐름	40.9	16.5	8.4	4.6	1.1
재무현금흐름	-103.0	12.8	107.2	-34.3	1.8
기말 현금	58.7	52.0	47.8	39.0	23.9

자료: 동사 사업보고서(2025.12.), 분기보고서(2026.03.), NICE평가정보(주) 재가공

■ 동사 실적 전망

동사는 고사양·고적층·고집적 인쇄회로기판으로의 제품 포트폴리오 전환을 추진하며, 자동차 전동화 대응 PCB 및 로봇 액추에이터용 소형·경량 PCB 신사업을 본격화할 계획이다. 자동차부품 부문은 완성차 업체와의 공급 계약을 기반으로 안정적인 매출 기반이 이어질 것으로 전망되며, 전문생산방식(EMS) 부문은 IT 전자기기 수탁 생산 수요 확대를 바탕으로 성장세가 기대된다. 중속기업 (주)우진을 포함한 PCB 생산능력 기반의 신규 거래선 확보가 추진되는 가운데, 고부가 PCB 비중 확대를 통한 수익성 개선이 기대된다.

서울경제 보도에 따르면 동사는 2026년을 구조 전환의 원년으로 설정하고 고부가 PCB 신규 거래선 진출 및 로봇 분야 신사업 출시를 본격화할 계획이며, 2026년 2월 완료된 유상증자 재원을 고사양 생산설비 구축에 활용할 예정이다. AI 관련 전자기기 수요 확대 및 자동차 전장화 추세는 동사의 PCB·자동차시트 복합 사업체제에 긍정적인 수주 환경을 조성하고 있으며, 유상증자 이후 이자비용 절감 및 재무구조 안정화로 수익성 회복이 기대된다.

동사의 2026년 매출은 1,180억 원이 전망되며, 유상증자 이후 설비 투자 자원 확보 추진을 통해 중장기적으로 적자 규모 축소 흐름이 기대된다. 본 전망치는 동사의 신규 사업 모멘텀(고사양·고적층 PCB 포트폴리오 전환, 로봇 액추에이터용 PCB 신사업 본격화 등)이 본격 반영될 경우 상회할 가능성이 있다.

그림 10. 동사 사업부문별 실적 및 전망

(단위: 억 원, %, K-IFRS 연결 기준)

연도별 실적 및 전망	2026년 실적 및 전망			
	2023	2024	2025	2026E
인쇄회로기판(PCB) 및 전사관리	1,133.9	873.9	927.5	980.0
자동차시트	208.7	190.8	178.8	153.0
전문생산방식(EMS)	41.1	43.2	43.1	41.0
기타	25.3	27.0	25.5	6.0
매출액	1,409.1	1,134.9	1,174.9	1,180.0

자료: 동사 사업보고서(2025.12.), 분기보고서(2026.03.), NICE평가정보(주) 재가공

V. 주요 변동사항 및 향후 전망

고사양 PCB·로봇 분야 진출로 도약하는 전장 부품 종합 파트너

동사는 2026년 고사양·고적층 PCB 설비 투자와 로봇 분야 진출을 통해 포트폴리오 전환을 본격화하고 있으며, 자동차 전동화 가속 및 로봇 산업 성장이라는 거시 트렌드가 동사의 수익 구조 개선과 신성장 기반 구축을 뒷받침하고 있는 것으로 전망된다.

■ 고사양·고적층 PCB 포트폴리오 전환으로 수익 구조 개선 추진

동사는 2026년을 고사양 PCB 사업 전환의 원년으로 설정하고 본격적인 체질 개선에 나서고 있다. 현재 주력 제품이 자동차용 범용 PCB 중심으로 구성되어 수익성이 제한적이었으나, 대표이사 전운관 및 특수관계인 전학수 와이에스피 대표이사가 직접 참여한 10억 원 규모의 제3자배정 유상증자(신주 200만 주)를 통해 고사양 PCB 생산 설비 투자 자금을 확보하였다. 이번 유상증자는 단순한 자금 조달에 그치지 않고, 최대주주 및 특수관계인이 직접 자금을 투입함으로써 경영진의 사업 전환에 대한 강한 의지를 대외적으로 확인시켜 주는 계기가 된 것으로 평가된다. 동사는 고적층·고집적 제품 기술력을 이미 보유하고 있어 설비 구축 완료 시 빠른 양산 전환이 가능한 것으로 확인된다. 자동차 전동화 가속에 따라 전기차 전장 부품에 요구되는 고사양 PCB 수요는 지속 확대되고 있으며, 전기차 한 대당 PCB 탑재 규모가 내연기관 차량 대비 약 두 배 수준으로 증가하는 구조적 트렌드가 수익 구조 개선 기대를 뒷받침하고 있는 것으로 판단된다. 아울러 초다층(MLB) 제품 판매 비중을 현재 70% 수준에서 80% 이상으로, 6층 이상 초다층 비중을 60% 이상으로 각각 확대하는 전략도 병행 추진 중에 있다.

■ 로봇·우주항공 등 고성장 신규 분야로 적용처 확장

동사는 기존 자동차 전장 중심의 고객 포트폴리오에서 벗어나 로봇 산업으로의 적용처 확대를 본격 추진하고 있다. 특히 액추에이터용 PCB 분야에서의 경쟁력 강화를 핵심 과제로 설정하고 기술 개발 및 영업을 병행하고 있으며, 정부의 지능형 로봇 산업 육성 방침과 삼성전자·현대자동차·LG전자 등 국내 대기업들의 로봇 사업 전략 추진이 시장 성장 모멘텀으로 작용하고 있는 것으로 확인된다. 자율주행, 산업용 로봇, 휴머노이드 로봇 등 다양한 로봇 분야에서 PCB에 대한 고사양·고집적 요구가 빠르게 증가하고 있으며, 동사가 자동차 전장 분야에서 장기 축적한 고다층 설계·임피던스 제어 기술이 로봇용 고밀도 PCB 요구사항을 충족하는 기술적 기반으로 기능할 것으로 기대된다. 아울러 인공지능·생명과학·우주항공 및 정밀공학 분야로의 기술 역량 확대도 중장기 성장 전략으로 추진 중에 있어, 고부가·고성장 분야로의 PCB 공급 기반 다변화가 향후 동사의 지속 성장을 견인할 핵심 동력으로 기대되는 것으로 판단된다.

■ 자동차 구성품 사업의 안정적 성장 및 종합 자동차 파트너십 강화

자동차 구성품 부문은 현대·기아자동차의 핵심 1차 협력사인 (주)용산과의 장기적 거래 관계를 바탕으로 안정적 성장세를 이어가고 있다. 청주 공장의 평균 가동률 110.9%를 유지하는 가운데 SQ 인증 S등급을 유지하며 고객 신뢰를 확보하고 있으며, 이는 완성차 품질 요구사항을 지속적으로 충족해온 동사의 제조 역량을 방증하는 것으로 평가된다. 인테리어 부품의 친환경·고감성화 트렌드에 발맞춰 제품 다각화 및 품질 혁신 역량을 지속 고도화하고 있으며, 유상사급 방식으로 원재료를 조달하여 원재료 가격 변동 리스크를 구조적으로 통제하는 점도 수익 안정성 측면에서 긍정적으로 평가된다. PCB 사업의 전장 기술력과 자동차 시트 사업의 완성차 공급 채널이 결합되어 단순 부품 공급사를 넘어 종합 자동차 솔루션 파트너로의 도약이 기대되며, 이러한 복합 사업 시너지가 동사의 중장기 기업 가치를 높이는 핵심 기반이 될 것으로 전망된다.

에이엔피(015260)

■ 최근 뉴스 및 향후 전망

☐ 프롬프트 : 동사의 최근 뉴스와 향후 전망에 대해 알려주세요

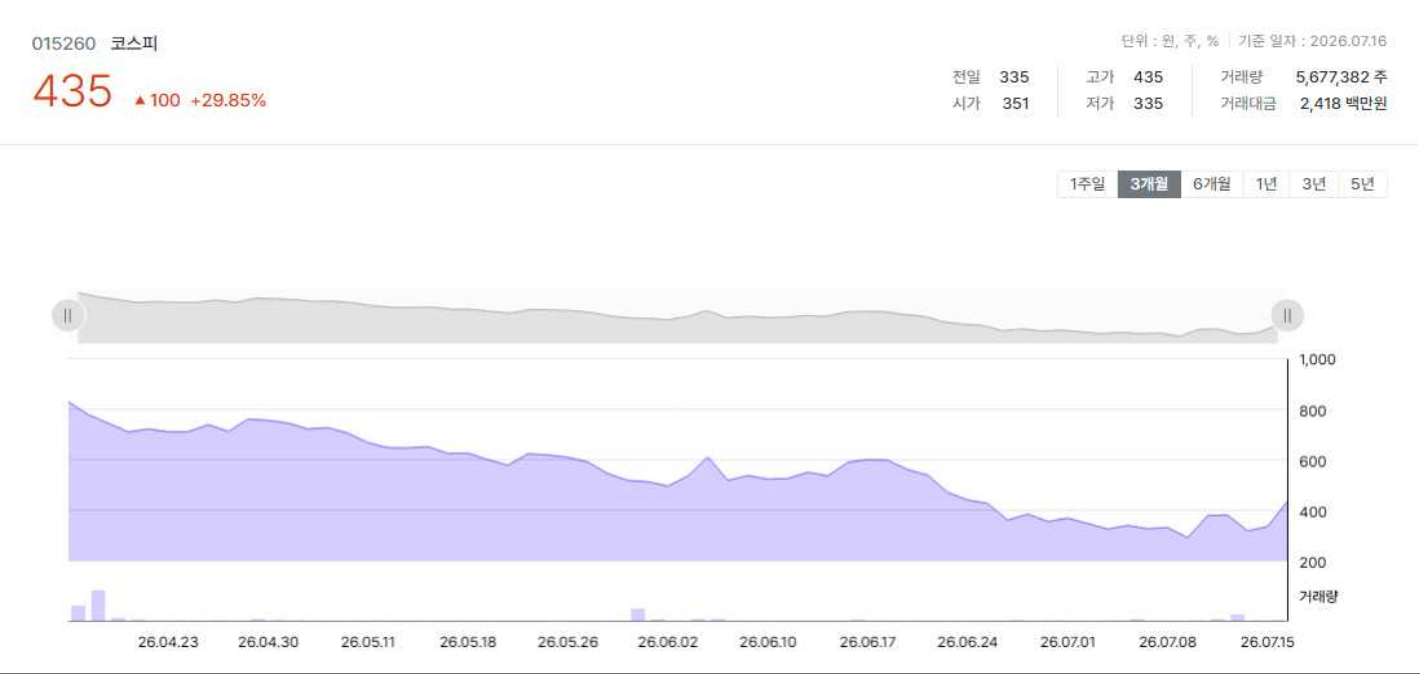
☒ 생성형 AI 답변 :
“에이엔피는 최근 매출원가 구조 효율화를 통해 매출총이익을 크게 개선하며 수익성 반등의 긍정적 기반을 마련한 점이 주목받고 있으며, 향후 전기차 보급 확대 및 차량 전장화 추세에 발맞춰 주력 제품인 자동차 전장용 PCB (인쇄회로기판)의 고부가가치화와 수출 채널 다변화를 통한 중장기적 흑자전환이 기대된다.”

* 자료 : Gemini

증권사 투자의견(하단)

작성기관	투자의견	목표주가	작성일
최근 6개월간 발간보고서 없음.			

시장정보(주가 및 거래량)



자료: NICE Bizline(2026.07.16.)

최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정여부

시장경보제도란?
한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자주의 환기 등을 통해 불공 정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다.
시장경보제도는 「투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목」의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다.
※관련근거: 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의7

기업명	투자주의종목	투자경고종목	투자위험종목
에이엔피	X	X	X